

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2020-024

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：未变更

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 103,618,645 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	圣邦股份	股票代码	300661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张勤	赵媛媛	
办公地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 13 层 3-1301	北京市海淀区西三环北路 87 号 13 层 3-1301	
传真	010-88825397	010-88825397	
电话	010-88825397	010-88825397	
电子信箱	investors@sg-micro.com	investors@sg-micro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的经营范围和主营业务

公司是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计及销售的高新技术企业。目前拥有16大类1,400余款在销售产品，涵盖信号链和电源管理两大领域，包括运算放大器、比较器、音/视频放大器、模拟开关、电平转换及接口电路、数据转换芯片、小逻辑芯片、LDO、DC/DC转换器、OVP、负载开关、LED驱动器、微处理器电源监控电路、马达驱动及电池管理芯片等。公司产品可广泛应用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、可穿戴设备、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等新兴电子产品领域。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、盈利模式

公司通过设计、代工制造并销售自主知识产权的模拟集成电路芯片产品，满足终端电子产品客户对高性能、高品质模拟集成电路元器件的需求，从而获得收入和利润。公司的产品需要根据市场的需求以及客户的实际应用要求，进行有针对性的定义及设计开发，并按照公司的技术标准委托代工厂商进行生产制造，经过严格的性能测试后，成为合格产品。公司所有产品均为正向自主研发，拥有完全自主知识产权，全部符合欧盟RoHS标准以及绿色环保标准，其综合性能品质达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先。通过为客户提供优质可靠的产品、贴近的支持与服务以及良好的性价比赢得了广大客户的信任与青睐，产品销量持续增长、客户群体不断扩大。

2、采购生产模式

公司属于无晶圆厂半导体公司。公司从晶圆代工厂采购定制的晶圆，交由封装测试厂封装测试，从而完成芯片生产。报告期内公司的晶圆代工厂主要为台积电，封装测试服务供应商主要为长电科技、通富微电和成都宇芯等。

3、销售模式

根据集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。形成这一销售模式的原因有：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身拥有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。报告期内公司销售收入主要来源于经销模式，预计未来几年公司仍将采用“经销为主、直销为辅”的模式进行产品销售。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

公司拥有较强的自主研发和创新能力，多年来在高性能信号链类模拟芯片和高效低功耗电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术，推出了具有“多样性、齐套性、细分化”特点的系列产品。公司的模拟集成电路芯片产品有着较为广泛的应用。报告期内，公司充分发挥其产品性能、功耗、可靠性和性价比等各方面的竞争优势，在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等应用领域保持了稳定的发展。在拓展既有市场领域的同时，公司也在物联网、新能源、人工智能、5G通讯等新兴应用领域积极布局，研发相关新品，占领市场先机、拓展市场份额。报告期内，公司经营稳定增长，实现营业收入79,249.49万元，同比增长38.45%；实现净利润17,472.85万元，同比增长68.50%，其中，归属于母公司股东的净利润17,603.25万元，同比增长69.76%。

（四）公司所处行业分析

公司所处行业为半导体集成电路行业。集成电路通常可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。模拟集成电路主要是指由电阻、电容、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理连续函数形式模拟信号（如声音、光线、温度等）的集成电路；与之相对应的是数字集成电路，后者是对离散的数字信号（如用0和1两个逻辑电平来表示的二进制码）进行算术和逻辑运算的集成电路，其基本组成单位为逻辑门电路。电子产品通常需要模拟集成电路和数字集成电路共同协作来完成各项功能。

公司的主营业务为模拟芯片的研发与销售，属于半导体集成电路产业中的集成电路设计行业。集成电路产业经过几十年的发展逐步形成了设计业、制造业、封装测试业三个细分行业。集成电路设计企业由于更接近和了解市场，通过不断创新开发出高附加值的产品，直接推动着电子设备的更新换代；同时，在创新中获取利润，在快速发展的基础上积累资本并作出新投入，为整个集成电路产业的增长注入了新活力，并带动了整个半导体产业的发展。由此，集成电路设计行业成为了集成电路产业的“龙头”。集成电路设计行业具有较稳定的增长能力和较强的抗周期能力。作为上游产业的集成电路制造业（晶圆代工）及封装测试业则在良率、成本、产能和交期等方面对集成电路设计业产生影响。

集成电路自诞生以来，带动了全球半导体产业在20世纪60年代至90年代的迅猛增长，进入21世纪以后随着市场日趋成熟，行业增速逐步放缓，2011年、2012年因受欧债危机、美国量化宽松货币政策、日本地震以及终端电子产品需求下滑等影响，半导体销售增速曾出现小幅下滑。随着2013年以来全球经济的逐步复苏，PC、手机、液晶电视等消费类电子产品需求不断增加，同时在以物联网、可穿戴设备、云计算、大数据、新能源、医疗电子和安防电子等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下保持了持续的增长，2018年甚至实现了双位数的增长。根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)数据，2018年全球半导体销售额为4,687.8亿美元，同比增长13.7%。2019年，全球固态存储及智能手机、PC需求增长放缓，产品库存高企，导致全球半导体需求市场下滑，同时全球贸易摩擦升温，中美贸易战也对半导体贸易市场造成较大影响，WSTS预计2019年全球半导体全球销售额将为4,089.88亿美元，与2018年相比将下降12.8%。市场调研机构同时预测随着存储器为代表的大宗半导体产品在经历了一段时间的价格下跌之后，在2020年第二季度将进入新一轮的涨价周期，带动整个市场上扬。同时5G建设全面推进、5G终端的出货量加大、物联网、人工智能、汽车电子、新能源、区块链等应用在2020年逐步推广落地等都将为2020年半导体市场回暖的最主要动力。然而，自2019年底开始在全球各地陆续爆发的新冠病毒肺炎疫情为包括半导体行业在内的

全球经济带来了很大的不确定性，一些市场调研机构开始下调对2020年的市场预期。

半导体集成电路行业作为全球信息产业的基础，在信息化潮流和产业资本的推动下，已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表，受到各国政府的大力支持。半导体产品的广泛应用也推动了信息化、智能化时代的来临。我国集成电路行业在过去的二十年来取得了长足的进步，一是得益于国家政策的大力扶持和倾斜，自2000年以来，我国政府将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，并颁布了一系列政策法规，以大力支持集成电路行业的发展。2000年国务院颁布的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、2014年国务院颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》、2016年国务院颁布的《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》、2016年发改委及工信部出台的《信息产业发展指南》、2017年科技部印发的《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》等相关政策的出台及国家集成电路产业投资基金的设立和运作有力地推动了我国集成电路产业的发展和壮大。国务院2018年政府工作报告也明确提出：“要加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”；二是得益于信息技术的进步和企业创新能力的提升，上游晶圆制造业与封装测试业的生产工艺水平的提高，以及设计企业自身研发能力的增强，都为集成电路设计行业从量变到质变的飞跃奠定了坚实的基础；三是得益于集成电路应用领域的拓展和国内市场需求不断扩大，人们对智能化、集成化、低能耗及绿色能源的需求不断催生新的电子产品及功能应用，国内集成电路设计企业获得了大量的市场机会；四是中国作为全球电子产业制造基地的地位不断巩固，国内集成电路设计企业凭借本地优势，紧贴市场需求，快速响应，客户认可度及品牌影响力不断提升，进而显现为整个中国集成电路设计行业的蓬勃发展。

我国目前重点培育和发展的战略性新兴产业都需要以集成电路产业作为支撑和基础，这给未来的集成电路设计行业带来很大的发展空间。物联网、人工智能、云计算、新能源、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备、5G通讯等新兴领域的发展将为集成电路设计行业带来持续不断的新动力。我国集成电路产业虽起步较晚，但经过近20年的飞速发展，我国集成电路产业从无到有，从弱到强，已经在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。据中国海关总署统计显示，2019年我国集成电路进口总额约为3055.5亿美元，同比下降2.1%；出口金额达到1015.8亿美元，首次突破千亿美元大关，同比增长20%。与全球半导体市场增速放缓并在2019年出现衰退形成鲜明对比的是我国半导体产业在2019年保持了增长态势。据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2019年中国半导体产业规模持续扩大，前三季实现销售额5,049.9亿元，同比增长13.2%。另据中国半导体行业协会设计分会统计，2019年集成电路设计行业销售总值保持增长，预计将达到3,084.9亿元，较2018年增长19.7%，将第一次跨过3,000亿元关口；截至11月底，全国共有1780家集成电路设计企业，较去年同期增长4.8%。预计2020年，以5G为代表的新基建、物联网、人工智能、汽车电子、新能源、芯片国产化替代需求等都将进一步推动我国集成电路产业的发展。

与国际主流集成电路公司几十年的发展相比，我国同行业厂商仍处于成长阶段，与国外大厂依然存在技术差距，尤其是在制造和设计环节所需的高端技术支持存在明显的短板，目前我国集成电路行业中的部分高端市场仍由国外企业占据主导地位，如国际主流的模拟集成电路公司依旧为德州仪器、亚德诺半导体、美信集成产品、意法半导体、英飞凌等美欧公司。此外，集成电路设计行业是典型的技术密集型行业，在电路设计、软件开发等方面对创新型人才的数量和专业水平均有很高要求。经过多年发展，我国已经累积出一批集成电路专业人才，但由于行业发展时间较短、技术水平较低，且人才培养周期较长，和国际顶尖集成电路企业相比，高端技术人才仍然十分紧缺。

总之，我国半导体产业市场规模巨大，国产集成电路的销售额与集成电路进口额相比差距较大，高端设备、技术和人才储备不足，使得我国集成电路自给率低，依然有很大的成长空间。展望未来，半导体集成电路产业在物联网、消费类、工业和汽车等市场保持增长的同时，人工智能、云计算、大数据、新能源、5G通讯等新兴领域也将持续发力，成为推动半导体市场持续增长的重要动力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	792,494,891.33	572,392,694.37	572,392,694.37	38.45%	531,505,272.15	531,505,272.15
归属于上市公司股东的净利润	176,032,451.57	103,694,105.16	103,694,105.16	69.76%	93,870,960.54	93,870,960.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,375,353.58	91,115,858.54	91,115,858.54	76.01%	87,603,010.15	87,603,010.15

经营活动产生的现金流量净额	144,515,528.33	83,674,688.46	83,674,688.46	72.71%	121,426,643.08	124,426,643.08
基本每股收益（元/股）	1.7022	1.3088	1.0059	69.22%	1.7393	0.9769
稀释每股收益（元/股）	1.6611	1.2921	0.9960	66.78%	1.7185	0.9704
加权平均净资产收益率	18.25%	12.84%	12.84%	5.41%	17.25%	17.25%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	1,393,471,331.54	1,062,305,962.92	1,062,305,962.92	31.17%	941,371,927.52	941,371,927.52
归属于上市公司股东的净资产	1,115,438,995.45	876,490,656.82	876,490,656.82	27.26%	761,303,037.57	761,303,037.57

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整。调增 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金流量 3,000,000.00 元，调减 2017 年度收到其他与筹资活动有关的现金流量 3,000,000.00 元。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	112,092,729.94	183,635,287.06	238,310,828.68	258,456,045.65
归属于上市公司股东的净利润	15,860,658.91	44,444,278.31	59,606,028.66	56,121,485.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,273,993.49	43,768,445.40	56,153,815.20	46,179,099.49
经营活动产生的现金流量净额	12,434,201.40	57,279,676.07	38,306,512.49	36,495,138.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,616	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京鸿达永泰投资管理有限责任公司	境内非国有法人	20.89%	21,643,606	21,397,204	质押		2,950,000
北京宝利鸿雅投资管理有限责任公司	境内非国有法人	9.59%	9,941,636	9,851,728	质押		1,885,000
哈尔滨珺霖投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.87%	9,190,680	9,190,680			

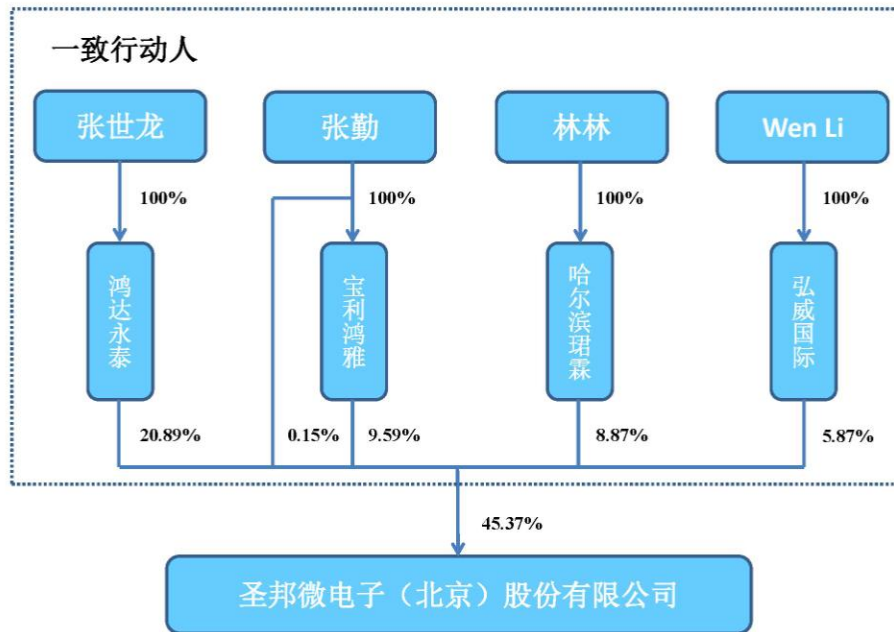
弘威国际发展有限公司	境外法人	5.87%	6,084,000	6,084,000		
CV VI HOLDING, LIMITED	境外法人	4.25%	4,399,851	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	2.46%	2,553,904	0		
全国社保基金四零六组合	其他	2.10%	2,176,578	0		
HONOUR BASE (HONG KONG) HOLDINGS LIMITED	境外法人	1.98%	2,047,445	0		
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.81%	1,880,248	0		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.75%	1,814,844	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、鸿达永泰（张世龙 100%持股公司）、宝利鸿雅（张勤 100%持股公司）、哈尔滨珺霖（林林 100%持股公司）、弘威国际（Wen Li 100%持股公司）签署了一致行动协议，支持和巩固张世龙的控制权，宝利鸿雅、哈尔滨珺霖和弘威国际为鸿达永泰的一致行动人，于其持有圣邦股份期间，在股东大会行使股东的表决权、向董事会及股东大会行使提案权、行使董事、独立董事及监事候选人提名权等有关经营决策事项时作出与鸿达永泰相同的意思表示，保持一致行动，即不作出与鸿达永泰意思表示相悖或弃权的意思表示，促使并保证所推荐的董事人选在圣邦股份的董事会行使表决权时，与鸿达永泰采取相同的意思表示。2、张世龙是公司实际控制人，其与 Wen Li 女士是夫妻关系，与张勤女士是表兄妹关系。				

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度，公司经营管理层在董事会的正确领导下，继续坚持“以市场为导向、以创新为驱动”的经营理念，紧密跟踪传统领域及新兴市场的发展趋势，布局并研发了一批与市场高度契合的新产品，并加大了现有产品的市场推广力度。公司的研发团队、市场销售团队不断充实壮大，使得公司整体研发实力得到明显提升，产品线得以拓展，产品的技术含量得以提高。通过全体员工的一致努力，公司在消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器和汽车电子等领域积极拓展，协助重点客户进行产品研发。同时，公司产品在物联网、智能家居、可穿戴设备、5G通讯等新兴市场的推广也取得了良好进展，产品逐渐得到客户的认可，并进入批量销售阶段，促进了公司营业收入的增长。

(1) 不断加强技术研发和技术创新能力，重视知识产权保护：

作为国内高端模拟芯片的领先企业，公司历来高度重视研发投入，源源不断的新产品成为公司持续发展的原动力。报告期内，公司研发费用投入13,130.94万元，较去年同期增加41.71%，占公司营业收入的16.57%。研发人员达到263人，占公司员工总数的65.91%，完成了300余款新产品的研发，涵盖信号链及电源管理两大产品领域。其中，信号链产品包括高性能运算放大器、高压比较器、高保真音频驱动器、高速模拟开关及接口电路等；电源管理产品则涵盖AMOLED显示电源芯片、微功耗LDO、高效低功耗DC/DC转换器、7A大电流升压转换器、锂电池充电及保护管理芯片、OVP、马达驱动芯片以及负载开关等多系列产品。随着物联网、可穿戴式设备、智能家居、5G通讯等新兴市场及应用的快速发展，各类智能设备对芯片性能的要求也在不断提高。公司根据相关市场需求的变化趋势，基于公司芯片产品在高性能、低功耗、小尺寸、高可靠性等方面的技术积累和优势进行了相关新产品的规划，展开了相应的研发工作，特别是针对TWS蓝牙耳机、传感器信号链、AD/DA数据转换、智能终端AMOLED显示屏供电管理、锂电池保护及充电管理、微功耗高效电源转换、大电流DC/DC电源转换、过压保护、负载开关、马达驱动芯片等产品方向开展研发并推出了一批达到国际先进水平的新一代模拟芯片产品。另外，在制造工艺方面，更多的新产品采用了0.18μm制程的新一代高压BCD工艺平台，这将有助于进一步降低芯片功耗、减小芯片面积，满足新一代消费类电子产品、物联网、移动智能终端等应用的需求。在封装工艺方面，除了传统的SOT、

DFN、QFN等封装工艺外，越来越多的产品采用WLCSP、SC70等小型封装以减小体积、提升性能，更加适用于便携式的智能移动终端产品。

报告期内，公司加强了知识产权相关工作的推进力度并取得明显成效，新申请技术专利115件（其中发明专利111件），申请数量较2018年同期增长两倍以上。同时，新增国内授权发明专利8件，新增国内授权实用新型专利1件，新增11件集成电路布图设计登记证书，新增国内注册商标6件。公司荣获全球电子技术领域最大媒体集团 AspenCore旗下《电子工程专辑》等媒体联合评选的2019年度“十大中国IC设计公司奖”；公司的高精度仪表放大器SGM620在“2019全球电子成就奖”评选中荣获“年度创新产品”奖；公司的新一代AMOLED显示屏电源芯片SGM38042获得第十四届“中国芯”优秀市场表现产品奖。

（2）传统领域保持继续增长的同时努力开拓新兴市场：

报告期内，公司在传统领域继续保持稳定的增长。除了传统的模拟芯片市场外，物联网、智能家居、新能源、人工智能、5G等新应用的涌现也为模拟芯片提供了新的发展机遇。公司紧跟市场发展趋势，在上述新兴领域积极布局、努力开拓。例如智能音箱、TWS蓝牙耳机、无人机等应用中采用了公司多款高性能信号链产品（如高速比较器、高保真音频驱动芯片、运放等）及电源管理芯片（包括锂电池保护及充电管理芯片、马达驱动芯片、LDO等）。同时，公司不断加强市场宣传和拓展力度，通过线上、线下等多种形式进行产品的宣传推广：如参加了2019慕尼黑上海电子展、2019深圳国际电子展；通过平面媒体、新媒体、企业微信公众号等方式推广公司的新产品并取得了良好效果。

（3）加速人才梯队建设，助力公司长效发展：模拟芯片设计行业存在人才储备不足、进入门槛高等客观因素，引进和培养优秀的模拟芯片设计、生产管理及市场销售人才

是公司人力资源工作的重要内容。报告期内，公司从人才引进、内部培养、薪酬考评体系等方面着手，加速了人才梯队建设，引进了多名国内外高端人才。

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，实施了2018年股票期权激励计划的预留授予，用以激发管理团队和核心骨干人员的积极性，增强公司凝聚力，助力公司长效发展。

（4）建立健全内部控制，不断完善公司治理：

公司严格按照相关法律法规及监管要求，并结合自身发展情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构。同时，为加强公司的信息披露工作，保证真实、准确、完整的披露信息，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司制定了相关《信息披露管理办法》和《内幕知情人登记备案制度》等，并根据监管要求不断更新修订相关具体内容。董事会、监事会有效的履行相关职责，逐渐规范相关议事规则和工作细则，确保三会工作的顺利开展及完成，完善公司法人治理结构。

模拟集成电路的特点是种类多、应用范围广。公司将继续推进既定的发展战略和经营计划，不断扩大研发团队和投入，在2020年持续推出更多更好的模拟集成电路新品，在5G通讯等新兴应用的带动下，借助国产化替代需求的东风实现下一年度的产值和利润增长目标。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信号链产品	241,941,455.98	136,860,048.97	56.57%	6.00%	8.82%	1.46%
电源管理产品	550,553,435.35	234,660,850.09	42.62%	59.97%	71.07%	2.76%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司实现营业收入 79,249.49 万元，较上年同期增加 38.45%，营业成本 42,097.40 万元，较上年同期增加 36.04%，归属于上市公司普通股股东的净利润 17,603.25 万元，较上年同期增加 69.76%。以上报告期内发生的重大变化原因为 2019

年公司积极拓展业务，产品销量增加，相应营业收入、营业成本以及归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”）。	董事会审批	
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。 根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。 本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。	董事会审批	
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“新非货币性交换准则”），明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。	董事会审批	
财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号。	董事会审批	

①新金融工具准则

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项 目	类别	账面价值	项 目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具）	--	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	--	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
	以成本计量（权益工具）	--	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
应收票据	摊余成本	--	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
			应收票据	摊余成本	--
应收账款	摊余成本	30,824,454.77	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
			应收账款	摊余成本	30,824,454.77
其他应收款	摊余成本	1,136,138.39	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
			其他流动资产	摊余成本	--
其他流动资产	摊余成本	517,000,000.00	其他应收款	摊余成本	1,136,138.39
			其他流动资产	摊余成本	517,000,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项 目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
资产：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--
交易性金融资产	--	--	--	--
应收票据	--	--	--	--
应收账款	30,824,454.77	--	--	30,824,454.77
应收款项融资	--	--	--	--

其他应收款	1,136,138.39	--	--	1,136,138.39
一年内到期的非流动资产	--	--	--	--
• 以摊余成本计量	--	--	--	--
• 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--	--	--	--
• 其他	--	--	--	--
其他流动资产	522,490,508.31	--	--	522,490,508.31
可供出售金融资产	--	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--	--
债权投资	--	--	--	--
其他债权投资	--	--	--	--
长期应收款	--	--	--	--
其他权益工具投资	--	--	--	--
其他非流动金融资产	--	--	--	--
负债：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--	--	--
交易性金融负债	--	--	--	--
股东权益：				
其他综合收益	8,422,682.90	--	--	8,422,682.90
盈余公积	39,766,672.50	--	--	39,766,672.50
未分配利润	287,984,751.73	--	--	287,984,751.73
少数股东权益	-	--	--	--

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	311,358.12	--	--	311,358.12
其他应收款减值准备	643,701.77	--	--	643,701.77

②新债务重组准则

由于本公司暂不涉及新债务重组准则所涉及业务，故新债务重组准则对报表项目名称和金额无影响。

③新非货币性交换准则

由于本公司暂不涉及新非货币性交换准则所涉及业务，故新非货币性交换准则对报表项目名称和金额无影响。

④财务报表格式

本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	225,898,349.88	225,898,349.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	30,824,454.77	30,824,454.77	
应收款项融资			
预付款项	746,631.66	746,631.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,136,138.39	1,136,138.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	104,600,582.44	104,600,582.44	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	522,490,508.31	522,490,508.31	
流动资产合计	885,696,665.45	885,696,665.45	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	114,800,000.00	114,800,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		0.00	
固定资产	16,364,642.85	16,364,642.85	
在建工程		0.00	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,253,506.64	7,253,506.64	
开发支出			
商誉	7,929,061.72	7,929,061.72	
长期待摊费用	14,761,309.24	14,761,309.24	
递延所得税资产	15,500,777.02	15,500,777.02	
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计	176,609,297.47	176,609,297.47	
资产总计	1,062,305,962.92	1,062,305,962.92	
流动负债：			
短期借款		0.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,014,830.58	51,014,830.58	
预收款项	7,750,256.95	7,750,256.95	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,032,067.49	33,032,067.49	
应交税费	8,247,895.00	8,247,895.00	
其他应付款	38,735,116.90	38,735,116.90	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	138,780,166.92	138,780,166.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,695,534.81	9,695,534.81	
递延收益	25,465,709.00	25,465,709.00	
递延所得税负债	11,873,895.37	11,873,895.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	47,035,139.18	47,035,139.18	
负债合计	185,815,306.10	185,815,306.10	
所有者权益：			
股本	79,533,345.00	79,533,345.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	494,210,619.94	494,210,619.94	
减：库存股	33,427,415.25	33,427,415.25	
其他综合收益	8,422,682.90	8,422,682.90	
专项储备			
盈余公积	39,766,672.50	39,766,672.50	
一般风险准备			
未分配利润	287,984,751.73	287,984,751.73	
归属于母公司所有者权益合计	876,490,656.82	876,490,656.82	
少数股东权益			
所有者权益合计	876,490,656.82	876,490,656.82	
负债和所有者权益总计	1,062,305,962.92	1,062,305,962.92	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	124,686,098.66	124,686,098.66	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	24,009,852.06	24,009,852.06	
应收款项融资			

预付款项	746,631.66	746,631.66	
其他应收款	28,380,761.54	28,380,761.54	
其中：应收利息			
应收股利	27,452,800.00	27,452,800.00	
存货	85,109,099.59	85,109,099.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	522,328,795.44	522,328,795.44	
流动资产合计	785,261,238.95	785,261,238.95	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	143,078,781.58	143,078,781.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	16,128,014.50	16,128,014.50	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,253,506.64	7,253,506.64	
开发支出			
商誉	7,929,061.72	7,929,061.72	
长期待摊费用	13,357,778.58	13,357,778.58	
递延所得税资产	14,146,783.89	14,146,783.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	201,893,926.91	201,893,926.91	
资产总计	987,155,165.86	987,155,165.86	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	46,618,207.68	46,618,207.68	
预收款项	1,280,280.84	1,280,280.84	
合同负债			
应付职工薪酬	28,620,066.80	28,620,066.80	
应交税费	7,290,751.86	7,290,751.86	
其他应付款	37,622,793.20	37,622,793.20	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	121,432,100.38	121,432,100.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,317,579.71	6,317,579.71	
递延收益	25,465,709.00	25,465,709.00	
递延所得税负债	1,189,654.29	1,189,654.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,972,943.00	32,972,943.00	
负债合计	154,405,043.38	154,405,043.38	
所有者权益：			
股本	79,533,345.00	79,533,345.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	514,542,695.80	514,542,695.80	
减：库存股	33,427,415.25	33,427,415.25	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,766,672.50	39,766,672.50	
未分配利润	232,334,824.43	232,334,824.43	
所有者权益合计	832,750,122.48	832,750,122.48	
负债和所有者权益总计	987,155,165.86	987,155,165.86	

调整情况说明

无

（3）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本期数据与前期数据无差异。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司于2019年5月28日与汪洋、祝丽娟签署股权转让协议，收购了上海萍生微电子科技有限公司51%的股权，随后本公司又对上海萍生微电子科技有限公司进行增资取得16.11%的股权。转股和增资构成了一揽子交易。两项交易完成后，本公司共持有上海萍生微电子科技有限公司67.11%股权。

本公司于2019年8月28日与杭州深谙微电子科技有限公司、杭州旷志科技有限公司及杭州励新企业管理咨询合伙企业签署增资协议，随后本公司对杭州深谙微电子科技有限公司增资取得53.85%的股权。